

TK129-J 导电银胶

产品说明

TK129-J 为美国 TiC 技术的最新产品。是单组份、低温贮存、中等粘度、高粘接强度的导电银胶。适用于数码管、点阵、LED 邦定、红外接收、发射管等光电器件等芯片的粘接和封装。

基本参数

颜色	银色
比重	3.21
粘度	8600 cps (23°C/10 rpm)
硬度	83
分解温度	380°C
玻璃化温度	110°C
剪切强度	大于 1100 psi
热膨胀系数	低于玻璃化温度 $40e-6^{TH}$; 高于玻璃化温度 $100e-6^{TH}$ 。
工作温度	-55°C 到 150°C (连续工作); -65°C 和 300°C (瞬间工作)。
热失重	200°C 0.22%; 300°C 0.65%; 400°C 2.60%。
体积比电阻	0.0002 欧姆-厘米
热传导系数	2.7 W/m · K
固化条件	150°C 60-90 分钟
贮存期	0°C 3 个月; -15°C 6 个月。
注意	使用时可适当搅拌, 常温下使用。

以上数据信息是基于我们在温度 25°C, 湿度 70% 的环境下对产品的研究测试所得到的典型数据, 目的是对你们的使用提供可能的建议, 但不能取代基于你们本身目的对该产品所做的操作性与适用性测试。由于我们无法预见各种最终使用条件, 钛克公司不能保证会对这些数据信息在客户使用过程中的准确性承担责任。作为一种建议, 并不代表你们可以以此为依据或许可对相关专利产品的否定。